

# 海通证券股份有限公司关于气派科技股份有限公司

## 2023 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：海通证券股份有限公司	被保荐公司简称：气派科技
保荐代表人姓名：薛阳、徐扬	被保荐公司代码：688216

### 重大事项提示

2023 年度，在经济发展放缓、行业终端需求不足等因素的影响下，全球及国内半导体市场面临较大压力，市场竞争不断加剧。面对复杂的市场环境及行业周期的变化，公司经营管理面临较大挑战。报告期内，气派科技主营业务毛利率为-17.43%，较上期下降 18.42 个百分点；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15,361.72 万元，同比减少 7,931.48 万元，仍处于亏损状态。公司仍然存在未来因行业持续低迷或经营不当等原因导致毛利率和净利润持续为负的风险。

2023 年度，公司生产经营正常，不存在其他重大风险。

经中国证券监督管理委员会《关于同意气派科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1714 号）批复，气派科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票 26,570,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 14.82 元，募集资金总额为人民币 39,376.74 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 33,822.46 万元。本次发行证券已于 2021 年 6 月 23 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）系承接其持续督导的保荐机构，持续督导期间为 2023 年 7 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日。

在 2023 年 7 月 13 日至 2023 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称“本持续督导期间”），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》

（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就本持续督导期间持续督导情况报告如下：

### 一、2023年度保荐机构持续督导工作情况

项目	工作内容
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。持续督导期间，协议相关方对协议内容做出修改的，应于修改后五个交易日内报上海证券交易所备案。终止协议的，协议相关方应自终止之日起五个交易日内向上海证券交易所报告，并说明原因。	保荐机构已与气派科技签署持续督导协议，该协议已明确双方在持续督导期间的权利义务。
3、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经审核后予以披露。	本持续督导期间，上市公司未发生需公开发表声明的违法违规事项。
4、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个交易日内向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，上市公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项。
5、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，对公司开展了持续督导工作。其中，保荐机构于2024年3月28日对上市公司进行了现场检查。
6、督促上市公司建立和执行规范运作、承诺履行、分红回报等制度。	保荐机构已督促上市公司建立和执行规范运作、承诺履行、分红回报等制度。
7、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	保荐机构持续督促、指导上市公司及其董事、监事、高级管理人员；本持续督导期间，上市公司及其董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求，并切实履行其所做出的各项承诺。
8、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人	保荐机构核查了上市公司治理制度建立与执行情况，上市公司《公司章程》、三会议事规则等制度符合相关法规要求，本持续督导期

项 目	工作内容
员的行为规范等。	间，上市公司有效执行了相关治理制度。
9、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构核查了上市公司内控制度建立与执行情况，上市公司内控制度符合相关法规要求，本持续督导期间上市公司有效执行了相关内控制度。
10、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促上市公司严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。
11、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。
12、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。
13、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管措施或纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	本持续督导期间，上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况。
14、关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，应及时向上海证券交易所报告。 上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐机构、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。 保荐机构、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。	本持续督导期间，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。 上市公司或其控股股东、实际控制人已对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。

项 目	工作内容
<p>上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、上市规则以及上海证券交易所其他规定的，保荐机构和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。</p>	
<p>15、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司未出现该等事项。</p>
<p>16、发现以下情形之一的，应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：</p> <p>（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；</p> <p>（二）中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；</p> <p>（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；</p> <p>（四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作；</p> <p>（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p>
<p>17、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。保荐机构对上市公司的定期现场检查每年不应少于一次，负责该项目的两名保荐代表人至少应有一人参加现场检查。</p>	<p>保荐机构制定了对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求。保荐机构于2024年3月28日对上市公司进行了现场检查，负责该项目的两名保荐代表人有1人参加了现场检查。</p>
<p>18、重点关注上市公司是否存在如下事项：</p> <p>（一）存在重大财务造假嫌疑；</p> <p>（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；</p> <p>（三）可能存在违规担保；</p> <p>（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；</p> <p>（五）资金往来或者现金流存在重大异常；</p> <p>（六）本所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。</p> <p>出现上述情形的，保荐机构及其保荐代表人</p>	<p>本持续督导期间，上市公司未出现该等事项。</p>

项 目	工作内容
应当督促公司核实并披露，同时应当自知道或者应当知道之日起15日内按规定进行专项现场核查。公司未及时披露的，保荐机构应当及时向上海证券交易所报告。	
19、识别并督促上市公司披露对公司持续经营能力、核心竞争力或者控制权稳定有重大不利影响的风险或者负面事项，并发表意见	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
20、关注上市公司股票交易异常波动情况，督促上市公司按照本规则规定履行核查、信息披露等义务	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
21、对上市公司存在的可能严重影响公司或者投资者合法权益的事项开展专项核查，并出具现场核查报告	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
<p>22、上市公司日常经营出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司经营的影响以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露：</p> <p>（一）主要业务停滞或出现可能导致主要业务停滞的重大风险事件；</p> <p>（二）资产被查封、扣押或冻结；</p> <p>（三）未能清偿到期债务；</p> <p>（四）实际控制人、董事长、总经理、财务负责人或核心技术人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；</p> <p>（五）涉及关联交易、为他人提供担保等重大事项；</p> <p>（六）本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。</p>	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
<p>23、上市公司业务和技术出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司核心竞争力和日常经营的影响，以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露：</p> <p>（一）主要原材料供应或者产品销售出现重大不利变化；</p> <p>（二）核心技术人员离职；</p> <p>（三）核心知识产权、特许经营权或者核心技术许可丧失、不能续期或者出现重大纠纷；</p> <p>（四）主要产品研发失败；</p> <p>（五）核心竞争力丧失竞争优势或者市场出现具有明显优势的竞争者；</p> <p>（六）本所或者保荐机构认为应当发表意见</p>	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。

项 目	工作内容
的其他情形。	
24、持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项，对募集资金存放与使用情况进行现场检查。	保荐机构对上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，督导公司执行募集资金专户存储制度及募集资金监管协议。截至报告期末，上市公司的募集资金账户已全部注销。
25、上市公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员是否存在未依法规范运作，未切实保障投资者的合法权益，侵害投资者利益的情况	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
26、保荐机构发表核查意见情况。	本持续督导期间，本保荐机构发表的核查意见情况如下：2023年9月12日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于气派科技股份有限公司2023年半年度持续督导跟踪报告》
27、保荐机构发现的问题及整改情况（如有）	本持续督导期间，上市公司存在业绩亏损，保荐机构将根据《保荐办法》等相关规定认真履行持续督导职责，对上市公司是否存在重大财务造假嫌疑等情况进行持续重点关注。

## 二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

海通证券持续督导人员对上市公司本持续督导期间的信息披露文件进行了事后审阅，包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查，保荐机构认为，上市公司严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 三、重大风险因素

公司面临的主要风险因素如下：

## （一）业绩大幅下滑或亏损的风险

报告期，受国际政治、经济环境影响，半导体行业处于下行周期和去库存周期，公司受行业影响，产能利用率不足，公司营业收入 5.54 亿元，同比微增 2.58%，公司归属于上市公司股东的净利润-13,096.69 万元，同比亏损增加 7,240.42 万元，若未来半导体产业持续低迷，公司业绩可能出现不能短期恢复或持续亏损的情况。

## （二）核心竞争力风险

### 1、集成电路封装测试领域技术及产品升级迭代风险

近年来，集成电路终端系统产品的多任务、小体积的发展趋势带动了集成电路封装技术朝着高性能、高密度、高散热、晶圆级、薄型化、小型化方向快速发展，相应的 FC、3D、CSP、WLCSP、MCM、SiP、TSV 等先进封装技术应用领域越来越广泛。日月光、安靠、长电科技、华天科技、通富微电等国内外领先企业均已较全面的掌握 FC、3D、CSP、WLCSP、MCM、SiP、TSV、Chiplet 等先进封装技术，而公司产品目前仍以 SOP、SOT 等传统封装形式为主，2023 年度，公司先进封装占主营业务收入仅为 32.49%。如果未来公司的封装技术与工艺不能跟上竞争对手新技术、新工艺的持续升级换代，将可能使得公司市场空间变小；或者公司不能对封装测试产品的应用领域和终端市场进行精准判断，快速识别并响应客户需求的变化，在新产品、新技术研发方面无法保持持续投入，或者正在研发的新产品不能满足客户需要，将难以开拓新的业务市场；进而对公司的经营业绩造成不利影响。

### 2、研发技术人员流失风险

公司自成立以来一直从事集成电路封装测试业务，所处行业为资金、资产、技术、管理和人才密集型行业，优秀的研发技术人员是公司赖以生存和发展的重要基础，是公司获得和保持持续竞争优势的关键。随着集成电路封装测试市场竞争的不断加剧及新的参与者加入，企业之间对人才尤其是优秀研发技术人员的争夺将更加激烈，若公司不能提供更好的发展平台、更有竞争力的薪酬待遇、设立具备较强吸引力的激励考核机制，公司将难以持续引进并留住优秀研发技术人员，公司将可能面临研发技术人员流失的风险；如果出现研发技术人员流失，公司还

将面临技术泄密的风险。

### **（三）经营风险**

#### **1、生产效率下降风险**

集成电路封装测试行业的生产模式最主要的特征是小批量、多批次、多品种，如何通过合理、有效的管理和组织调度，生产出符合客户要求的产品，同时满足客户快速交货的需求是企业核心竞争力的重要体现。

随着公司生产规模的不断扩大、工艺流程的日益复杂，如果集成电路行业持续处于低迷的市场行情，公司未来不能在管理方式上及时创新，生产人员技术水平及熟练程度无法保持或者持续提升，公司将会面临生产效率下降的风险。生产效率下滑将导致公司生产规模无法保持或持续扩大，不仅会使产品交期延长、竞争力削弱及客户流失，同时还会使公司无法保持在成本控制方面的优势，将会对公司经营业绩产生不利影响。

#### **2、业绩及毛利率波动风险**

公司主要从事集成电路封装测试业务，经营业绩会随着终端产品市场的波动而变化；同时，集成电路封装测试行业竞争激烈，价格相对透明，相应的封装测试企业整体毛利率水平不高。未来若终端产品市场出现较大波动，或者随着市场竞争的加剧、竞争者的数量增多及技术服务的升级导致公司调整产品及服务的定位、降低产品及服务的价格，公司产品毛利率水平存在较大幅度波动的风险，从而对公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。

#### **3、原材料价格波动风险**

公司主要原材料包括引线框架、塑封树脂、丝材（金丝、银线、铜线、合金线）和装片胶。公司原材料价格受市场供求变化、宏观经济形势波动等因素的影响，若未来公司原材料价格出现大幅波动，而公司产品售价不能及时调整，将给公司的盈利能力造成不利影响。

#### **4、产能消化风险**

随着公司募集资金项目的逐步建成和自有资金扩产的逐步实施，将有效提升

公司半导体封装测试产能，使公司生产和交付能力得到进一步的提升。当半导体行业出现了周期性波动，行业景气度下行，如果公司下游市场需求不及预期、市场竞争加剧或公司市场开拓受阻，将可能导致部分生产设备闲置、人员富余，使得公司产能利用率不足、产能消化存在风险，从而无法充分利用全部生产能力而增加产品单位成本费用负担，将对公司未来的经营状况带来不利影响。

#### **（四）财务风险**

##### **1、存货积压和呆滞风险**

公司原材料的交期一般 1-2 个月，而公司主要客户要求的交货周期较短，一般为 15 到 30 天。为快速响应客户的订单需求，公司需要根据订单、客户需求预测以及市场情况等进行原材料采购。若客户需求预测发生调整，市场情况发生变化，公司采购的原材料不能及时通过有效的销售订单投入生产，将导致公司的原材料产生积压或者呆滞的风险，导致占用公司资金及产生存货跌价损失的风险，对公司的业绩水平产生不利影响。

##### **2、有息负债风险**

截止 2023 年 12 月 31 日，公司有息负债余额 40,547.68 万元，其中短期借款金额为 17,481.00 万元，一年以内到期的长期借款金额为 1,216.00 万元，一年以内到期的长期应付款金额为 1,069.68 万元，公司有息负债余额较大。若未来银行信贷政策收紧或公司经营活动现金流得不到改善，可能造成公司流动资金紧张，公司有息负债偿付存在一定压力，对公司经营带来不利影响。

##### **3、新增折旧和摊销费用降低公司盈利能力的风险**

公司募投项目和自有资金扩产建成后分步达产，公司固定资产和无形资产规模将进一步扩大，固定资产折旧和无形资产摊销将相应增加，由于实现预期效益需要一定时间，新增的折旧与摊销会导致公司的毛利率、每股收益、净资产收益率等指标出现一定幅度的下降，短期内对净利润增长构成不利影响。如果宏观政策变化、市场变化等具有不确定性，项目投产后可能会出现短期产能消化困难，无法实现预期收益的风险，可能对公司盈利能力造成一定程度的不利影响。

## （五）行业风险

### 1、市场竞争加剧风险

近年来，随着国家对集成电路行业的大力支持，使大量资金涌入集成电路行业，各地争先恐后的上马集成电路项目，当大量的集成电路封测项目投产后，会造成市场竞争加剧，如果公司不能持续保持较强市场竞争力，将对公司经营造成不利影响。

### 2、行业波动及需求变化风险

受国际政治、经济环境的影响，2022至2023年半导体行业呈下行趋势。公司主营业务为半导体行业集成电路封装测试，集成电路行业的发展状况对公司的生产经营具有重大直接影响。集成电路行业具有与宏观经济同步的特征，其波动幅度甚至会超过全球经济波动幅度。若未来宏观经济形势变化，全球集成电路产业市场出现较大波动，将对公司经营业务和经营业绩带来较大的影响。

## （六）宏观经济风险

目前全球经济仍处于周期性波动当中，尚未出现经济全面复苏的趋势，依然面临下滑的可能，全球经济放缓可能对半导体行业带来一定的不利影响，进而间接影响公司的业绩。未来，若国内和国外经济若持续低迷，可能导致消费者消费预期降低，进而持续影响半导体行业，对公司生产经营产生不利的影响。

## 四、重大违规事项

2023年度，公司不存在重大违规事项。

## 五、主要财务指标的变动原因及合理性

近三年，公司主要财务数据及指标如下：

### （一）主要会计数据

单位：元

项目	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
----	-------	-------	--------------

营业收入	554,296,295.91	540,378,207.66	2.58
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	521,338,180.95	523,668,667.00	-0.45
归属于上市公司股东的净利润	-130,966,944.18	-58,562,694.49	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-153,617,170.51	-74,302,326.93	不适用
经营活动产生的现金流量净额	37,192,636.71	-74,033,628.87	不适用
<b>项目</b>	<b>2023年末</b>	<b>2022年末</b>	<b>本期末比上年同期末增减(%)</b>
归属于上市公司股东的净资产	745,300,254.67	889,487,128.67	-16.21
总资产	1,865,430,086.08	1,788,084,682.87	4.33

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-1.24	-0.55	不适用
稀释每股收益(元/股)	-1.24	-0.55	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.45	-0.70	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-16.06	-6.15	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-18.84	-7.80	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	8.47	9.44	减少0.97个百分点

2023年度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少7,240.42万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少7,931.48万元，主要原因为：一是公司产品销售均价有所下降；二是，因公司募投项目等扩产项目实施，导致固定资产折旧上升；三是，为适应公司后续的发展，公司适当的加大了人才储备和组织厚度，导致人力成本上升；四是，电费竞价上网改革及洁净厂房面积增加等原因导致电费增加。

报告期内，公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期比较减少，主要原因系本期净利润较上年同期减少所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额转负为正，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金有所减少，同时销售回款及时使得销售商品收回的货款有所增加。

## 六、核心竞争力的变化情况

### （一）核心竞争力分析

#### 1、技术优势

集成电路封装测试属于技术密集型行业，行业创新主要体现为生产工艺的创新，技术水平主要体现为产品封装加工的工艺水平。气派科技通过多年的技术研发积累与沉淀，现已形成了 5G MIMO 基站 GaN 微波射频功放塑封封装技术、高密度大矩阵集成电路封装技术、小型化有引脚自主设计的封装方案、封装结构定制化设计技术、产品性能提升设计技术、精益生产线优化设计技术等核心技术，推出了自主定义的 CDFN/CQFN、CPC 和 Qipai 封装系列产品，对贴片系列产品予以了优化升级等，并已申请了发明专利，公司还掌握了 Flip-Chip、MEMS 等一流的封装技术并成功量产。

#### 2、人才优势

气派科技的多数高级管理人员及部分核心技术人员拥有多年的集成电路技术研发或管理经验，具备国际领先企业的行业视野或国内一流企业的从业经验，是一支经验丰富、结构合理、优势互补的核心团队，为持续提升公司核心竞争力、设计新产品、开发新工艺提供强有力的人力资源支持。

公司不仅在研发人员及管理团队中具备人才优势，也将人才优势进一步推广到生产一线，为近年来公司精益生产线优化设计技术的深层次应用奠定了人力资源基础。公司持续开展六西格玛等培训，建立了“新生力”“后备经理人”培养体系等，公司具备完整人才梯队和人才培养体系。

#### 3、生产组织与质量管理优势

集成电路封装涉及的产品种类繁多，目前公司的主要封装产品包括 MEMS、FC、Qipai、CPC、SOP、SOT、LQFP、QFN/DFN、CDFN/CQFN、TO、DIP、PDFN

等系列。相对齐全的产品线为公司满足客户多元化的产品需求和建立市场优势发挥了重要作用。但同时，不同的产品类型往往需要不同生产工艺、生产设备、供应商体系、技术及管理队伍相匹配，这对封装企业的生产组织能力和质量管理提出了严格的要求。

公司致力于持续提升生产管理水平和强化质量管理，培养了经验丰富的研发技术人员和一大批生产管理人才。基于丰富的生产经验和成熟的技术工艺，公司采用柔性化的生产模式，能根据客户的订单要求，灵活地分配生产计划和产品组合，迅速地调试和组合生产线，实现高效率、多批次、小批量的生产，有效地增强了市场反应能力。公司建立了严格的质量管理体系，完善了工作规范和质量、工艺控制制度，并通过了 ISO9001:2015 质量管理体系、IATF14969:2016 汽车行业质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系和 ISO22301 业务连续性管理体系认证。

#### **4、地域优势**

公司客户主要为集成电路芯片设计企业，其对交货时间要求严格，交货时间短和便利的地理位置可为集成电路芯片设计企业减少库存，节约运输时间和资金成本，及时应对来自客户的随机性和突发性需求，方便企业与客户的交流和反馈，增强其竞争力。

公司地处粤港澳大湾区，电子元器件配套市场的迅速崛起以及半导体设计行业的蓬勃发展为气派科技提供了快速发展的沃土。公司充分发挥地域优势进行客户开拓，通过上门接送货物等服务方式节约运输时间、缩短交货期和降低物流成本，加深与客户的交流，销售服务利于得到客户认可，提高公司市场占有率。

#### **5、规模优势**

芯片设计公司选择长期合作伙伴时，着重考虑封装测试厂商是否具备足够的产能规模，是否具备大批量、高品质供货的能力。为构建公司在国内封装测试行业的规模优势，公司在东莞投资完成了自有厂房的建设，为持续的产能的扩充以及技术改造提供了物理条件。

公司现已发展成为华南地区规模最大的内资封装测试企业之一，已形成了自

身的规模优势。同时，公司仍在进行持续的资本性支出，不仅提升了公司技术层级，丰富了产品类别，优化了客户结构，还使得公司产能和销售规模也得到进一步提升，继续利用规模优势来巩固和提高公司在行业内的竞争地位。

## 6、智能化生产优势

近年来，公司秉承打造智能化工厂建设为目标，按照数字工厂总体设计和布局，先后从网络安全、系统架构、数据分析等多方向规划、持续建设，陆续导入制造执行系统（MES）、先进排产计划系统（APS）、设备控制自动化系统（EAP）等系统，并与企业资源计划管理系统（ERP）集成，实时数据平台与生产管理系统实现互通集成。从而建设成制造资源数字化、生产过程数字化、现场运行数字化、质量管控数字化、物料管控数字化的智能工厂，生产数据通过工况在线感知、智能决策与控制、设备自律执行大闭环过程，不断提升设备性能、增强自适应能力。实现研发、生产、运营的全流程数字化管理，最优化分派生产订单和工作任务，全流程追溯生产过程中的物料、治具条码等，有效提高制造资源利用率、人均产能、产品质量良率，有效降低生产成本。2022年，公司全资子公司广东气派荣获“东莞市智能制造示范项目”“东莞市智能工厂”称号，2023年，广东气派精益生产管理和质量精准追溯两个场景入选工信部智能制造优秀场景名单。

### （二）核心竞争力的变化情况

2023年度，气派科技的核心竞争力未发生重大不利变化。

## 七、研发支出变化及研发进展

### （一）研发情况

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	46,963,869.56	50,995,394.83	-7.91
资本化研发投入	-	-	/
研发投入合计	46,963,869.56	50,995,394.83	-7.91
研发投入总额占营业收入比例（%）	8.47	9.44	减少 0.97 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

截至 2023 年末，公司累计获得专利 254 项，其中发明专利 37 项、实用新型专利 144 项。

报告期内获得的知识产权情况如下：

项目	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	13	15	91	37
实用新型专利	42	23	186	144
外观设计专利	0	0	88	73
软件著作权	0	0	1	1
其他	0	0	0	0
<b>合计</b>	<b>55</b>	<b>38</b>	<b>366</b>	<b>255</b>

#### 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

#### 九、募集资金的使用情况是否合规

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人募集资金累计使用及结余情况如下：。

单位：元

项目	金额
IPO 募集资金净额	338,224,573.85
加：募集资金利息收入减除手续费	4,481,269.77
减：募投项目累计资金使用情况	341,884,849.27
减：结余转出金额	820,994.35
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00
其中：专户存款余额	0.00
理财产品余额	0.00

截至 2023 年 12 月 31 日，公司所有募集资金专户均已注销完毕。

公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《保荐办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——

规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金管理和使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

#### 十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2023 年 12 月 31 日，气派科技控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有公司股份的情况如下：

单位：万股

序号	姓名	职务	期初持股数	期末持股数	2023 年的质押、冻结及减持情况
1	梁大钟	董事长、总经理、核心技术人员	5,115.00	5,115.00	无
2	白瑛	董事	1,080.00	1,080.00	无
3	李泽伟	董事、财务总监、总经理助理	29.50	29.50	无
4	邓大悦	董事	-	-	无
5	左志刚	独立董事	-	-	无
6	任振川	独立董事	-	-	无
7	常军锋	独立董事	-	-	无
8	孙少林	监事会主席	-	-	无
9	赵红	监事	9.00	9.00	无
10	宋晓莉	职工监事	-	-	无
11	饶锡林	副总经理、核心技术人员	28.00	28.00	无
12	文正国	副总经理、董事会秘书	31.00	31.00	无
13	陈勇	副总经理(已离职)	25.00	25.00	无
14	胡明强	副总经理(已离职)	30.00	26.40	减持

截至 2023 年 12 月 31 日，气派科技控股股东、实际控制人及现任董事、监事和高级管理人员持有的气派科技股份均不存在质押、冻结和减持的情况。

#### 十一、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项

经核查，截至本持续督导跟踪报告出具之日，上市公司不存在按照《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于气派科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人: 薛阳

薛 阳

徐扬

徐 扬

